

# Tabla de contenido Procesos Lead Free

---

## Unidad 1

- 1.1 Desperdicio de alta tecnología
- 1.2 Iniciativa de soldadura libre de plomo
  - 1.2.1 WEEE, ROHS
  - 1.2.2 Japón, Estados Unidos
- 1.3 Consideraciones libre de plomo
  - 1.3.1 Aleaciones Libre de Plomo

## Unidad 2

- 2.1 Introducción para soldadura
- 2.2 Seguridad
- 2.3 Cuáles son mis estándares de ejecución
- 2.4 ¿Qué equipo voy a usar?
- 2.5 Circuito Impreso
- 2.6 Punta del cautín
- 2.7 Mantenimiento de la punta del cautín
- 2.8 Selección de la punta del cautín

## Unidad 3

- 3.1 Líquido Flux
- 3.2 Soldadura de alambre con núcleo de Flux

## Unidad 4

- 4.1 Componentes Through Hole
  - 4.1.2 Componentes TH- **Precauciones**
  - 4.1.3 Componentes TH- **Soldadura.**
  - 4.1.4 Componentes TH- **Criterios de Aceptación.**

## Unidad 5

- 5.1 Comparación de la apariencia de la soldadura

## Unidad 6

- 6.1 Introducción al Montaje por Superficie Libre de Plomo (SMT)
- 6.2 Porque Soldar a Mano

## Unidad 7

- 7.1 Componentes SMT Chip & MELF
  - 7.1.2 Componentes SMT Chip & MELF - **Precauciones**
  - 7.1.3 Componentes SMT Chip & MELF - **Soldadura**
  - 7.1.4 Componentes SMT Chip & MELF - **Criterios de Aceptación**

## Unidad 8

- 8.1 Componentes SMT PLCC (TDC tipo "J") & QFP, SOIC, SOT (TDC tipo "Ala de Gaviota")
  - 8.1.2 Componentes SMT PLCC (TDC tipo "J") & QFP, SOIC, SOT (TDC tipo "Ala de Gaviota" -- **Precauciones**
  - 8.1.3 Componentes SMT PLCC (TDC tipo "J") & QFP, SOIC, SOT (TDC tipo "Ala de Gaviota" -- **Soldadura**
  - 8.1.4 Componentes SMT PLCC (TDC tipo "J") & QFP, SOIC, SOT (TDC tipo "Ala de Gaviota" -- **Criterios de Aceptación**

## Unidad 9

- 9.1 Componentes BGA
  - 9.1.2 Componentes BGA - **Precauciones**
  - 9.1.3 Componentes BGA - **Soldadura**
  - 9.1.4 Componentes BGA - **Criterios de Aceptación**

## Unidad 10

- 10.1 Asignación de tareas practicas